

Cutting Edge

第69期中間 事業のご報告

平成19年4月1日～平成19年9月30日

証券コード：6146



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

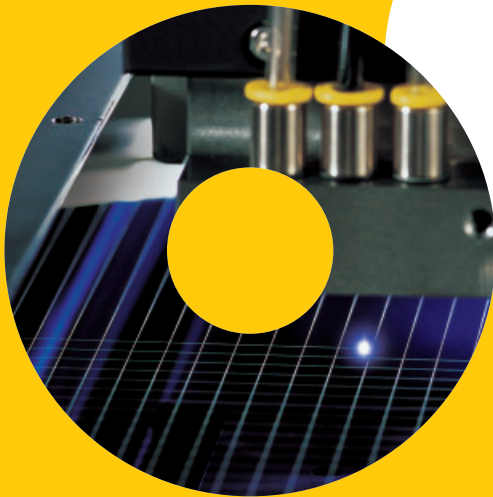
身近でグローバルな
DISCOを探して下さい。

DISCO Technology 生活の中のKiru・Kezuru・Migaku

DISCO Business DISCOのグローバルネットワーク

DISCO Story ⑤ DISCO VALUES誕生！





「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と人の暮らしに貢献しています。

高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは...

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという思いが込められているからです。

遠い科学を身近な快適につなぐとは...

科学は日々進歩しています。しかしどれほど進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

ディスコが追い求める成長とは...

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダーとの価値交換を通じ、長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

Contents 目次

- ② 株主の皆様へ
- ③ DISCO Technology
- ⑤ DISCO Business
- ⑦ DISCO Values
- ⑧ DISCO News
- ⑨ 中間連結財務諸表
- ⑫ 株主アンケート結果
- ⑬ 会社情報および株式の状況
- ⑭ DISCO Story... ⑤

To Our Shareholders 株主の皆様へ

当中間期の経営環境と業績および通期の見通し

当中間期の世界経済は、米国での住宅市場の調整による景気停滞が懸念されましたが、先進諸国および新興市場地域ともに概ね安定的な成長軌道を保ちました。半導体業界におきましては、メモリ価格急落による設備投資の手控え等がありましたが、デジタル家電やモバイル機器の大容量化や高精細化などの需要進展にあわせて、半導体生産量は増加基調をたどりました。当社の精密加工ツールは、このような市場環境を受け、中間期として過去最高の売上を更新し、精密加工装置についてもメモリ市況の調整の影響を若干受けたものの売上は好調に推移しました。特に、パッケージシンギュレーション用ダイシングエンジンやシリコンウェーハ向けグライндаは、新規設備の増強等に支えられてきわめて堅調に推移しました。この結果、第2四半期は四半期として過去最高の売上・受注高を記録し、当中間期の売上高は前年同期比15.9%アップの461億40百万円、経常利益は同16%アップの110億31百万円となりました。

下期は、PC、携帯電話、薄型TVなどのデジタル製品の需要も引き続き堅調で、半導体市場・電子部品市場も底堅く推移すると見込まれています。また、当社が戦略分野として重点的に開発を進めてきたレーザーソー、薄化・ストレスリリーフ技術についても動きが加速すると予想しています。通期の見通しとしては、連結売上高は過去最高の972億円、経常利益219億円、当期純利益128億円を見込んでおります。

本年度も当社は、企業理念である「DISCO VALUES」の一層の浸透を図りながら、従業員一人ひとりの能力を進化させる取り組みとして行っているPIM（*）活動にさらに力を入れ、組織全体のパフォーマンスの向上を図ってまいります。「DISCO VALUES」があるべき姿を示す羅針盤とすれば、「PIM」はそれを実現に導く「エンジン」にあたるものです。今後も積極的に開発投資を行いながら、業務の徹底した効率化を図り、当社の事業領域である高度なKiru・Kezuru・Migaku技術の可能性を徹底して追究してまいります。

配当について

株主様への利益還元につきましては、2005年度より採用しております配当政策に則り、当中間配当金は1株当り35円（前中間期は1株当り30円）とさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2007年12月

*Performance Innovation Management：常に進化し続ける組織を構築するマネジメント手法。業務上の目標に対する指標を設定、進捗状況を誰にも判るよう表示「見える化」して、短いサイクルでトラッキングを行い、組織的に気づきを得ることにより活動を推進。



代表取締役社長

ディスコの高度なKKM（切る・削る・磨く）技術は、身の回りのさまざまなシーンで活躍しています。当社の主力製品であるダイサ、グラインダ、そして精密加工ツールは、現代生活に欠かせないパソコンや携帯電話、デジタルカメラ、液晶テレビなどに搭載されている半導体や電子部品の切断・研削・研磨を行っています。

半導体や電子部品は、生活のあらゆる「便利」を実現しています。例えば、信号機。現在、省電力・長寿命の特性を持つLEDを光源とするものに切り替わっています。デジタルカメラは、さらに高精細、薄型になり、メモリーカードも大容量で、手ごろな値段のものが次々に発売されています。さらに、自動車用の半導体も技術革新が進んでおり、生産量が増えることが予想されます。

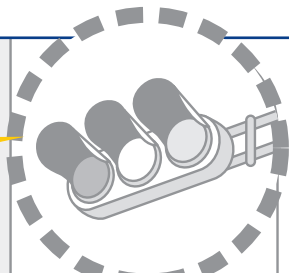
ますます便利になる暮らしを実現したい。—ディスコはKKM技術をさらに進化させていきます。

高輝度LED（信号・照明）

LEDは、信号機、PCモニターや携帯画面のバックライト、自動車のライトなど多量の照明器具に用いられます。基板が化合物半導体という特殊素材であるため、先端技術であるレーザーダイシングが活躍しています。



DFL7160加工点



携帯電話

BRICsにおける買い替え需要、欧米における3Gサービス（高速モバイル、テレビ電話、3Dゲームなど）への需要シフトなど、携帯電話は生産台数・機能ともに半導体需要を牽引しています。携帯電話に搭載されるLSI、SAWフィルター、LED、COMSセンサーなどの加工にディスコのKiru技術が活かされています。



DFD6361加工点

ICカード

定期券やキャッシュカードなどに埋め込まれるICチップは、外部からの圧力に耐えうる高い強度が求められます。ディスコのストレスリリーフ技術（DBGプロセス+プラズマによるドライエッチング）が、研削後のダメージとチップ分割時のチッピングを抑え、チップ強度への信頼性ニーズに応えています。



DFG8560+DFE8060

自動車用半導体

安全制御やエンジン・変速機・動力伝達装置などのエレクトロニクス化、ハイブリッド車の普及などにより、車載半導体の需要が急速に高まっています。ディスコの先端技術TAIKOプロセスは、ハイブリッド車に搭載されるパワー半導体の生産プロセスの革新を担っています。



TAIKOウェーハ

携帯音楽プレーヤー

2006年には1億台に達し、爆発的な普及が続く携帯型音楽プレーヤー。そこに搭載されるNAND型フラッシュメモリの需要が急伸しています。ディスコの薄型化やストレスリリーフ技術が、メモリの薄型化・大容量化に貢献しています。



DGP8760加工点

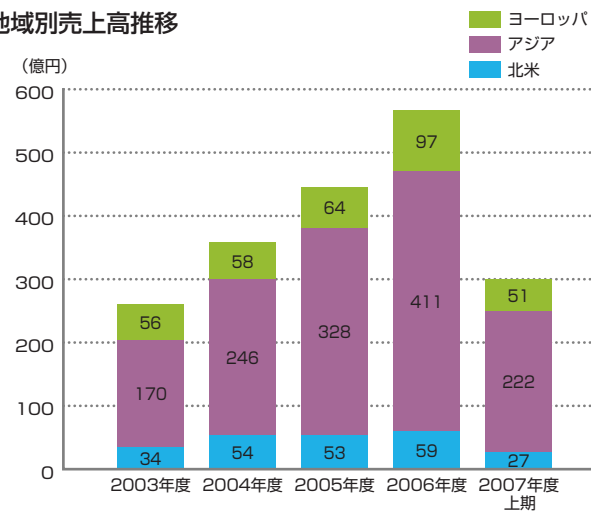
ディスコでは「常にお客様の近くにいる」ことをモットーに、1969年の米国での子会社設立以来、積極的に海外に拠点を設立してきました。現在、15カ国、37拠点のグローバルなネットワークを築いています。

近年、グローバル化の進展により、半導体メーカーをはじめとする当社のお客様の生産拠点がアジア地域にシフトしています。そのため、当社の地域別売上高構成比もアジア地域が50%近く（2006年度実績）を占めています。

お客様にとって最適なKiru・Kezuru・Migakuソリューションを提供するために、販売・サービスに加え、海外の拠点にもアプリケーション・ラボラトリーを設置し、迅速な対応ができる体制となっています。

ディスコは、今後も世界中のお客様の高度化する技術ニーズにこたえるべく、海外においても更なる質の向上を目指します。

地域別売上高推移



● ディスコオフィス (販売、保守点検、テストカットサポート)
 ● ディスコオフィス (販売、保守点検)
 ● 代理店

ヨーロッパ 連結売上高の約10%を占めるヨーロッパ市場では、世界的な半導体メーカーや電子部品メーカー向けに多くの先端ソリューションを提供しています。昨年度は、携帯電話の高機能化に伴う電子部品向けのダイサの販売が大きく拡大しました。

- DISCO HI-TEC EUROPE GmbH (DHE)
- 設立年 1982年
- ドイツ ミュンヘン

アジア 世界のハイテク製品生産基地であるアジア地域は、高い成長を続けています。韓国・台湾地域をはじめ、近年では中国においても様々なハイテク製品の生産が行われています。量産用半導体向けの全自動ダイサをはじめ、半導体パッケージを切断するダイシングエンジン、薄化用グラインダなどが主力製品となっています。

- DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD
- 設立年 1984年
- シンガポール
- DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
- 設立年 1998年
- 中国 上海

北米 生産拠点のアジア地域への移管により、売上規模は小さいものの、大手半導体メーカーが戦略を立案・決定する地域であるため、北米地域は、当社にとって非常に重要な地域です。当社は顧客満足 (CS) 活動に注力していますが、米インテル社より7年連続でSCQI賞 (サプライヤーの品質改善賞) を受賞するなど高い信頼性を維持しています。

- DISCO HI-TEC AMERICA, INC.
- 設立年 1969年
- 米国 サンタクララ

人それぞれに個性があるのと同様、会社にも社風と呼ばれる企業の個性があります。ディスコは、お客様に提供する製品が常にディスコらしい製品である、ことに強いこだわりを持っています。「ディスコらしい」製品は、お客様の信頼や満足を生み出す源泉となり、より強い価値交換につながると考えています。

ディスコらしい製品とはどのようなものでしょうか？ ディスコでは、あらゆる製品はお客様の加工ニーズにあわせたアプリケーションを実現するために存在している、と考えています。技術者は、お客様の生産プロセスの背景を考え、最適な加工結果を実現するには何が必要かを徹底的に追究します。その結果、あらゆる装置は、お客様ごとに異なるソリューションを実現するために、セミオーダーメイドで作られているのです。

さらに製品開発においても生産性はもちろんのこと、デザイン性や環境・健康・安全等の基準への適合、省スペース、省エネルギー、使いやすさを配慮するなど、お客様に感動をもたらす製品づくりに努めています。



お客様

- A社**
- ○○○ を薄く切りたい
 - 生産ラインスペース □□□ 以内に

- B社**
- △△△ をきれいに削りたい
 - スピードは ●●● で

- C社**
- ××× を磨きたい
 - 日本以外の国 ◆◆◆ で

お客様ごとに異なるソリューションに合わせたセミオーダーメイド製品の提供

ディスコ



BCM*対応力向上を目的とした工場新棟の建設

当社製品は世界規模で高い市場シェアを有していますが、地震などの災害時にメーカーとしての供給責任を果たすため、精密加工装置の製造を行っている桑畑工場において、免震構造の新棟を建設することにいたしました。また子会社ダイイチコンポーネッツにおいても、茅野工場に免震の新棟を建設します。2006年に決定した本社R&Dセンタ拡張などの大型設備投資に続く大きな投資となります。

*BCM: Business Continuity Management 災害など緊急時における事業継続管理の意。



桑畑工場（広島県呉市）
投資額：100億円
完成予定：2009年夏



茅野工場（長野県茅野市）
投資額：25億円
完成予定：2009年夏

台湾現地法人 DISCO HI-TEC TAIWAN設立

当社は、この冬に中華民国（台湾）に資本金約1億円、従業員約20名の規模で、現地法人を設立いたします。台湾は競争力のあふれる半導体受託加工会社がひしめく世界的な生産拠点です。ディスコにとっても台湾市場の重要性は高く、これまで代理店を通じてサービスを行ってまいりました。お客様の近くにディスコがいることで代理店と一丸となって、お客様のプロセスの高度化など様々なニーズに質の高いサービスを提供し、顧客満足度を高めることが可能になります。

「次世代認定マーク」を取得しました

ディスコは、社員の育児サポートは企業として当然の役割とと考えています。当社は、女性社員も数多く活躍しているため、仕事と育児を両立できる環境づくりを積極的にすすめています。2005年度よりつわりの時期などに取得できる「妊産婦健康管理休業」、育児休業からの復帰後「勤務時間の短縮」など、仕事と家庭の両立支援制度を拡充してきました。男性社員も有給休暇として、育児休業が取得できる制度を導入し、現在、11名が育児休業を取得しています。これらの取り組みが認められ、本年5月「次世代認定マーク」（厚生労働省認定）を取得しました。



Financial Statements

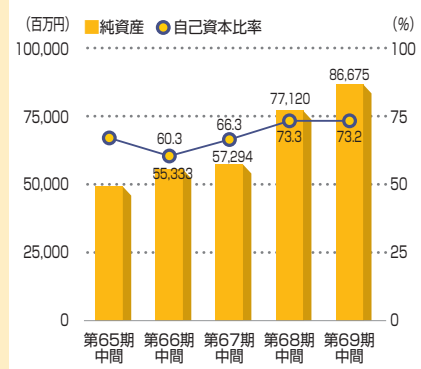
中間連結財務諸表(要旨)

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	第68期中間 平成18年 9月30日現在	第69期中間 平成19年 9月30日現在	第68期通期 平成19年 3月31日現在
資産の部			
流動資産	68,170	73,113	75,799
固定資産	36,482	44,493	37,991
有形固定資産	29,555	37,034	33,603
無形固定資産	912	892	925
投資その他の資産	6,014	6,565	3,462
資産合計	104,652	117,606	113,791

純資産・自己資本比率



純資産は前年同期比95億55百万円増加しました。売上の好調に伴う利益剰余金の増加などにより、株主資本は前年同期比92億56百万円増加。自己資本比率は負債純資産の合計額が増えたため、前年同期比とほぼ同様の73.2%となり、高水準の自己資本比率を維持しています。

(単位:百万円)

科目	第68期中間 平成18年 9月30日現在	第69期中間 平成19年 9月30日現在	第68期通期 平成19年 3月31日現在
負債の部			
流動負債	24,456	28,184	28,819
固定負債	3,076	2,747	3,148
負債合計	27,532	30,931	31,967
純資産の部			
株主資本	76,013	85,269	80,551
資本金	14,392	14,510	14,485
資本剰余金	15,474	15,592	15,567
利益剰余金	46,194	55,221	50,553
自己株式	△49	△55	△53
評価・換算差額等	668	791	755
その他有価証券評価差額金	239	40	59
為替換算調整勘定	428	750	696
新株予約権	9	126	65
少数株主持分	428	488	450
純資産合計	77,120	86,675	81,823
負債、純資産合計	104,652	117,606	113,791

ポイント 固定資産の増加

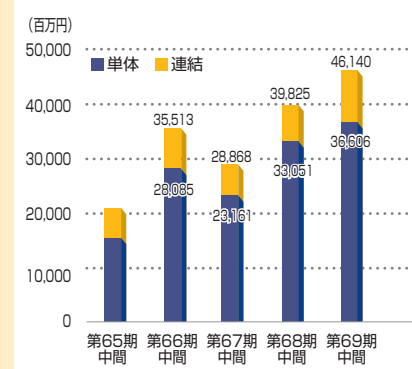
有形固定資産は前年同期比74億79百万円増加しました。本社・R&Dセンター新棟建設および工場増設など設備投資による建設仮勘定等の増加、試験研究のための装置購入等による固定資産の増加によるものです。これらの資産は今後の開発ならびに生産能力拡大に寄与することになります。

中間連結損益計算書

(単位:百万円)

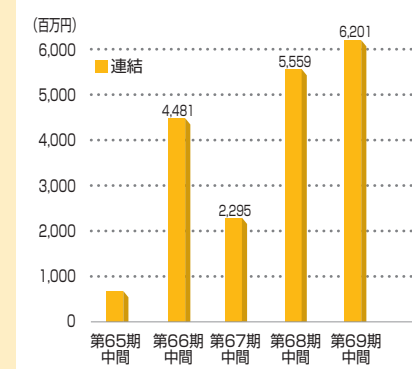
科目	第68期中間 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	第69期中間 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日	第68期通期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
売上高	39,825	46,140	86,160
売上原価	18,711	22,350	42,106
販売費及び一般管理費	11,523	12,763	24,529
営業利益	9,590	11,026	19,524
営業外収益	178	294	497
営業外費用	255	289	354
経常利益	9,513	11,031	19,667
特別利益	27	77	309
特別損失	272	75	2,261
税金等調整前中間(当期)純利益	9,268	11,033	17,715
法人税、住民税及び事業税	3,742	4,029	7,450
法人税等調整額	△73	748	△720
少数株主利益	38	53	49
中間(当期)純利益	5,559	6,201	10,936

売上高



半導体メーカー等による新設備の増強や需要分野の拡大などにより特に装置はICパッケージやサブコン向けの切断装置、素材ウェーハ向け研削装置等が業績を牽引し、また精密加工ツールの販売も高水準で推移したため、連結売上高は前年同期比15.9%増加して461億40百万円となりました。

中間純利益



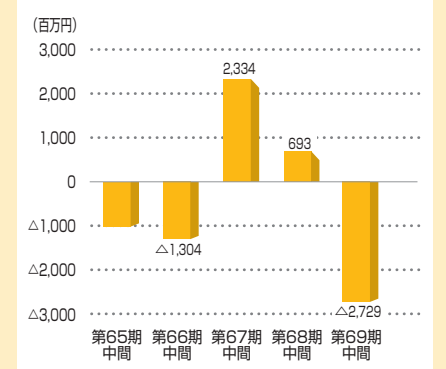
前年同期比6億42百万円の増益となりました。対売上高純利益率は13.4%となり前年同期比0.6ポイント低下しましたが、売上高の増加に伴い高い利益率を維持しました。

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	第68期中間 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	第69期中間 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日	第68期通期 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,407	3,333	13,194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,714	△6,062	△8,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,529	△1,879	△2,428
現金及び現金同等物に係る換算差額	88	51	227
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△747	△4,556	2,041
現金及び現金同等物の期首残高	22,003	24,045	22,003
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	21,255	19,488	24,045

フリーキャッシュ・フロー



本社・R&Dセンターの新棟建設や生産工場の能力増強のために投資キャッシュ・フローが活発化し、前年同期比34億22百万円減少して、フリーキャッシュ・フローは△27億29百万円となりました。

中間連結株主資本等変動計算書

第69期中間(自平成19年4月1日至平成19年9月30日)

(単位:百万円)

科目	株主資本					評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成19年3月31日 残高	14,485	15,567	50,553	△ 53	80,551	59	696	755	65	450	81,823
中間連結会計期間中の変動額											
新株の発行	25	25			50						50
剰余金の配当			△ 1,528		△ 1,528						△ 1,528
中間純利益			6,201		6,201						6,201
自己株式の取得				△ 1	△ 1						△ 1
その他			△ 4		△ 4						△ 4
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)						△ 18	54	36	60	37	134
中間連結会計期間中の変動額合計	25	25	4,668	△ 1	4,717	△ 18	54	36	60	37	4,851
平成19年9月30日 残高	14,510	15,592	55,221	△ 55	85,269	40	750	791	126	488	86,675

(注) 平成19年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

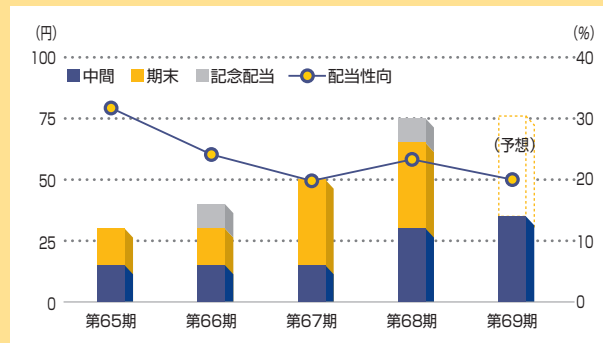
DISCOの配当政策

配当性向は連結の純利益の20%とし、ただし利益水準に関わらず、安定配当として20円を最低限維持いたします。

赤字の場合を除き、配当及び法人税等支払い後の現預金残高が、技術資源購入資金(技術特許購入、ベンチャーへの出資等)及び設備拡張資金、有利子負債返済資金等の予定必要資金額を超過した場合は、超過金額の3分の1を目処に配当として上乗せします。

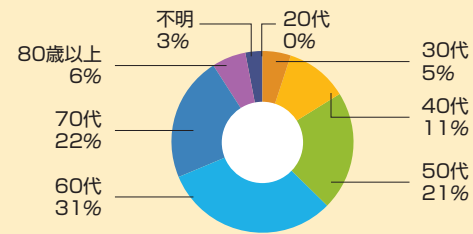
なお3期連続で連結純利益が赤字になった場合は、上記安定配当の20円を見直す可能性があります。

1株当りの配当金推移

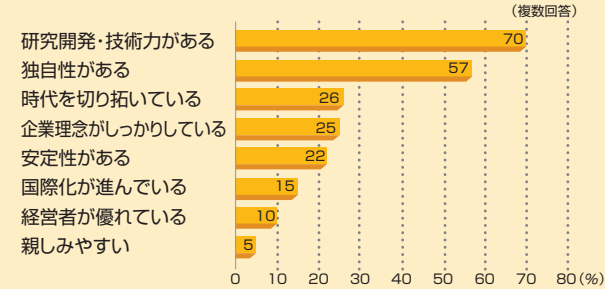


「第68期事業のご報告」にて実施したアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。1,950件を超すご回答をいただき、回答率は15.1%となりました。皆様の貴重なご意見をIR活動に役立てていきたいと考えております。今後も定期的にアンケートを実施する予定です。次回は、来年6月を予定しております。

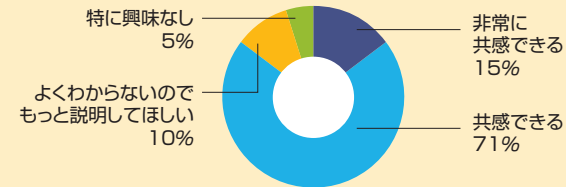
アンケート回答者年齢層



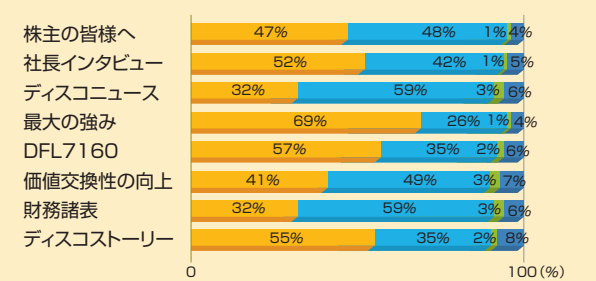
DISCOに対してどのようなイメージをお持ちですか?



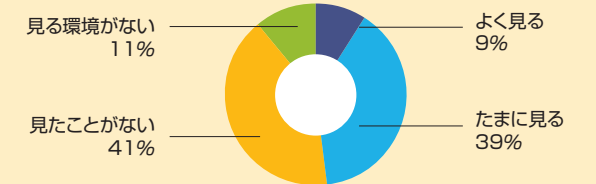
当社の経営理念DISCO VALUESについて



第68期事業のご報告について各項目の評価を教えてください。



当社の「株主・投資家情報」サイトの利用状況



ホームページでご覧いただけます。

自由コメントなど、当紙面では載せきれなかった内容を、当社「株主・投資家情報」サイトにて掲載しております。

IRニュースメールの配信登録をお待ちしています。

決算発表やプレスリリースなど、IR関連情報を即時受け取ることができます。この機会にぜひご登録下さい。



DISCO Information

会社情報および株式の状況（2007年9月30日現在）

会社概要

本社所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金	14,510百万円
従業員数	1,453名
主な事業内容	<p>精密加工装置 → 製造および販売 → メンテナンスサービス → オペレーションやメンテナンスの研修サービス → 解体リサイクル事業 → リースおよび中古品販売</p> <p>精密加工ツール → 製造および販売 精密部品の有償加工サービス</p>
事業所	本社・R&Dセンター 広島事業所（呉工場、桑畑工場、長谷工場）
国内拠点	仙台支店、大阪支店、九州支店 信州営業所、名古屋営業所

ディスコグループ関連会社

国内法人	株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ 株式会社ディーエスティー 株式会社ディーエスティー九州 株式会社ダイイチコンポーネッツ
海外法人	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD. JETSIS INTERNATIONAL PTE LTD DD Diamond Corporation DISCO-SEA AMERICA, INC. TECNISCO (SuZhou) Co., Ltd DHK Solution Corporation

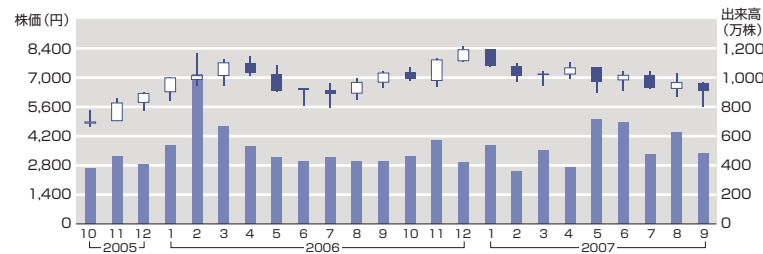
役員

名誉会長	関家 憲一 (取締役・監査役)
代表取締役社長	溝呂木 斉
常務取締役	関家 圭三 関家 一馬
取締役	関家 英之 梶山 啓一 溝呂木 隆夫 田村 隆夫
常勤監査役	玉利 晋 高柳 忠雄
監査役	浅海 芳久 黒沼 忠彦 荒井 一尚 吉永 晃

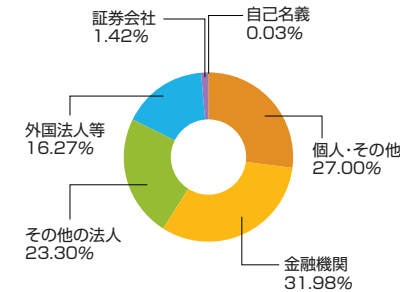
株式概要

上場市場	東京証券取引所 市場第一部（証券コード6146）
発行済株式総数	33,992,718株
株主数	14,057名
大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株) [信託口] : 4,214千株 / 12.40% 日本マスタートラスト信託銀行(株) [信託口] (株)ダイイチ企業 : 2,602千株 / 7.65% (株)ダイイチホールディングス : 1,998千株 / 5.88% (株)OCTAGON LAB : 1,704千株 / 5.01% 関家 臣二 : 1,348千株 / 3.97% 資産管理サービス信託銀行(株) [信託口 他] : 1,347千株 / 3.96% 関家 憲一 : 1,030千株 / 3.03% (株)オレンジコーラル : 846千株 / 2.49% 日本生命保険相互会社 : 768千株 / 2.26%

株式チャート



所有者別株式数分布状況



DISCO Story..... 5

〈1993年~2001年〉

【全6回シリーズ】



DISCO VALUES 誕生！

Xプロジェクトの生み出した新型装置は順調に販売を重ね、ディスコの業績はパソコンブームに沸く半導体・電子部品業界の驚異的な伸びに支えられ、拡大が続きました。その一方で、社長の関家憲一（現名誉会長）は明確で合理的な経営ビジョン、社員のエネルギーを一つにする企業文化の必要性を強く感じていました。

これまでの成長は、1970年代に装置開発に乗り出した時のような「何でもやってやろう」というチャレンジ精神あふれる企業文化に支えられたものでした。しかし、縦型拡散炉事業への進出などによる規模の拡大に伴い、中間管理職層を外から多く招聘するうち、様々な価値観が輻輳するようになっていました。

ビジョンをどのようにつくるのか、空転の時間が過ぎていきました。そして、経営陣は経営基盤構築の専門機関（Gray Institute of Management）とともに、経営ビジョンとその実現の基礎となる企業文化について、協働で研究することにしたのです。

1995年12月20日。10名の役員をメンバーとするDISCO FUTURE PROJECT-αがスタートしました。まず、経営基盤全体のフレームを再確認し、結果ビジョンに優先する領域の「企業としての価値観」（これは企業文化の核ともなる）を明確にすることから着手しました。毎月1回、企業が社会の中で果たすべき役割は何か、ディスコの事業領域は何であるべきかなど、企業活動の原点から見つめ直す議論が行われました。当初は、それぞれの考え方の違いにぶつかったものの、徹底的な討議を経る中で、共通の価値観が形成さ

れていきました。1997年12月、2年間の討議の成果を社員に向けて発表する『未来発表会』を開催。進むべき方向や企業としてのあるべき姿を示した『DISCO VALUES』と2010年にディスコがどのような企業でありたいかという目標地点を示した『DISCO VISION』が発表されました。

その後、DISCO VALUES (DV) の更なる充実とともに構築・公式化された領域を浸透させ、実践するための取り組みが始まりました。この共有のためのシステムも経営システムの一つとして開発・導入されました。この活動を通し「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」を基準とする、当たり前を大切に、といった考え方を組織に浸透させることで、組織の力が強くなり、トップに集中していた権限の委譲が少しずつ進んでいきました。

ディスコがDISCO VALUESという新しい羅針盤を手にし、新たな目標へむけ進んでいこうとした頃、世界的なIT景気の波が押し寄せました。半導体・電子部品メーカーの旺盛な設備需要に応えるため、必死で増産対応を重ねる数ヶ月が続き、こうして2000年度は、過去最高の業績となりました。しかしその翌年、ITバブルははじけ、世界的な不況も重なり、ディスコの売上高も前年比59%減少。しかし、将来に対して不安はありませんでした。ディスコは、売上に大きくすることを目的とせず、DVに示されている『高度なKiru・Kezuru・Migaku技術で遠い科学を身近な快適につなぐ』ことをミッションとして質的に向上することを成長と考えているからです。

株主メモ	
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金 受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年9月30日
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日とします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 (同送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-7111 (フリーダイヤル)
同取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店
公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載します） ただしやむを得ない事由により電子公告ができないときは 日本経済新聞に掲載します。
証券コード	6146

さらに詳細なIR情報は (株主・投資家情報ページ)をご覧ください。

決算発表資料をはじめ、IR関連情報を即時に掲載しております。
また、直近を含めて過去数年分の資料が閲覧できる「IR資料室」やディスコの事業についてご説明した「ディスコについて」、株式関連のお知らせやIRカレンダーなど、内容を充実させております。
皆様のアクセスをお待ちしております！

〈株主・投資家情報〉ページ



<http://www.disco.co.jp/>

お知らせ

○配当金のお受取方法について

振込口座をご指定されておられない株様には従来、「郵便振替支払通知書」にて配当金をお受取り頂いておりましたが、平成19年10月1日に日本郵政公社が民営化されたことに伴い、「郵便振替支払通知書」に代わって「配当金領収証」にて配当金をお受取り頂くこととなりました（従来のとおり、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて配当金をお受取りできます）。

“Cutting Edge”とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほかに、「最先端」という意味があります。ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解頂くために、常に最先端の技術を提供することを通じて、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

